

双组份导热灌封胶

GF300是一款低粘度高效导热有机硅双组份灌封胶，导热系数 $3.0\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ，分为A、B组分，按照1:1混合，混合均匀后能自排泡和常温固化，固化后具有防尘、防水防震、阻燃、密封、粘接、导热功能和优异的填缝效果，可用于发热电子元件的导热封装。



特性和优点

- 导热系数 $3.0\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
- 操作时间可调
- 高电气绝缘
- 流动性、浸润性好
- 可实现自动化作业

典型应用

- OBC, DC-DC, 连接器, 传感器, 放大器等
- LED, 电源, 功率转换器, 变压器, 高压电阻器

***操作时间：**混合后，在操作时间内使用完毕

典型属性

属性	典型值	测试方法
颜色(A/B)	白色/蓝色	目视
粘度(cps)	part A: $11,000 \pm 2,000$	ASTM D2196 @7号转子/转速60rpm
	part B: $11,000 \pm 2,000$	
操作时间(h) @ 25°C	1~2	A/B混合后在一起粘度上升到初始值两倍的时间
固化时间(h) @ 25°C	<4	
固化时间(h) @ 60°C	<0.5	
固化后		
密度(g/cc)	3.0 ± 0.1	ASTM D792
硬度(Shore 00)	60 ± 10	ASTM D2240
拉伸强度(MPa)	0.3	ASTM D412
断裂伸长率(%)	100	ASTM D412
撕裂强度(N/mm)	0.5	ASTM D624
耐温范围($^\circ\text{C}$)	-60~200	/
防火性能	V-0	UL 94
保质期(月)	3	温度< 40°C 密封储存、避免暴晒
电性能		
击穿电压(kV/mm)	>7.0	ASTM D149
介电常数(@1MHz)	6.7	ASTM D150
体积电阻率($\Omega\cdot\text{cm}$)	10^{13}	ASTM D257
导热性能		
导热系数($\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$)	3.0 ± 0.3	ISO 22007-2
热膨胀系数(ppm) @ $-40\sim150^\circ\text{C}$	80 ± 10	ASTM E831-2014

在本文档中提供的任何信息都被认为是准确的。所有规格如有更改，恕不另行通知。所有产品和服务均按销售条款和条件出售。卖方或制造商均不对侵权行为或合同中的任何直接、偶然或后果性损失或损害承担责任，包括因使用或无法使用产品而造成的利润或收入损失，除非双方和制造商的官员签署协议，否则此处未包含的卖方或购买方的任何声明，采购订单或建议均不具有任何效力。

©版权所有2019, AOCHUAN TECHNOLOGY.